



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20081216001
2008 年 12 月 22 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 品質保証部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

CC1020/1021xxx製品 STATSChipPac社 組立サイト追加変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	CC1020/1021xxx 製品 STATSChipPac 社 組立サイト追加 現行：AMS 社組立サイト 変更後：AMS 社組立サイト及び STATSChipPac 社 組立サイト	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	2009 年 3 月下旬の出荷より予定しています。 (サンプルにつきましては、2009 年 2 月上旬より予定しています。)	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	-	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。
また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容：弊社 HPA（ハイパフォーマンスアナログ）“CC1020/1021xxx”製品について、現行の製造サイト AMS 社（オーストリア）に加え STATSChipPAC 社（シンガポール）製造を追加し認定しました。製造サイト毎の製造部材は下記の様になり、出荷梱包部材につきましても、追加認定したサイトで現在使用しております部材の使用とさせていただきます。尚、今回の変更で、製品についての互換性（寸法/公差）、外観、動作特性、品質、信頼性への影響はありません。

変更内容
組立サイト

現行
AMS社（オーストリア）

変更後
AMS社（オーストリア）
STATSChipPAC社（シンガポール）

項目	現行	追加変更
組立サイト	AMS 社（オーストリア）	STATSChipPac 社（SGP）
Leadframe	CDA 194, 100/0 Sn/Pb	NiPdAu finishing
Mold Compound	HITACHI CEL-700ZHF10	MCSM0051
Bond Wire	Au, 32 μ m	UB, Au, MK Electron (MKE), 25.4 μ m

理由：安定供給確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
CC1020RSS	CC1020-RTR1	CC1021RSS	CC1021-RTR1	HPA00471RSSR
CC1020RSSR	CC1020RUZ	CC1021RSSR	CC1021RUZ	
CC1020-RTB1	CC1020RUZR	CC1021-RTB1	CC1021RUZR	

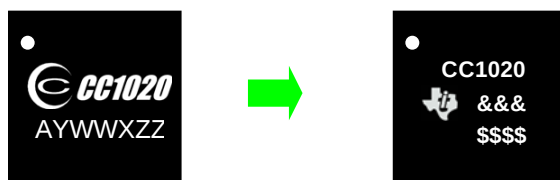
製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地(22L)/原産国(23L)の表示が下記の様になり、出荷ラベル表示箇所例を示します。また、製品表示の変更について記載します。

項目	現行	追加変更
組立サイト	AMS 社（オーストリア）	STATSChipPac 社（SGP）
原産地(22L):ASO	AUS	STS
原産国(23L):ACO	AUT	SGP



図1 出荷ラベルの表示箇所例



A = Code for Pb-Free
Y = Year
WW = Mfg. Week
X = Code for ASE
ZZ = Letters for free choice

&&& = 1st 3 Charcters of trace code(86M)
\$\$\$\$ = Last 4 charcters of trace code(11CG)

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験 - 試料構成詳細

Qual Device:	CC1020RUZ	Die Size (mm):	3.6576 X 2.8702
Die Protective Coating:	10KACN	-	-
Assembly Site:	SCS	Package/ Code/ Pin:	VQFN / RUZ/ 32
Mount Compound:	EPAB0009	Mold Compound:	MCSM0051
Bond Wire:	1.0 mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu
MSL	JEDEC, LEVEL3-260C		

信頼性試験結果

Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails
ESD - HBM	500 V	3/0
ESD - CDM	250 V	3/0
ESD - MM	50 V	3/0
** Temp Cycle	-65/150C, 1000 cyc	77/0
** Autoclave	121C, 96 hrs	77/0
Thermal Path Integrity	JEDEC-L3,192hrs/30C / 60%	12/0
X-Ray	Top / Side	5/0
Physical Dimensions	Per package drawing	5/0
Latch Up	Electrical Test	6/0
Electrical Char	Full temp & Voltage range	Pass
BLR TC	-40/125C ,Modeling	Pass
Manufacturability (A/T)	As per assembly site spec	Pass
Manufacturability (FAB)	As per assembly site spec	Pass
** - Test requires Moisture Preconditioning JEDEC L3-260C		